MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

SiC MOSFETチップの出荷梱包形態

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

SiC MOSFETチップの出荷梱包形態

・出荷時の梱包形態はお客様の様々なウエハおよびチップの保管環境やダイボンド装置に合わせて下記から選択が可能です。
・外装箱や内装箱など詳細な仕様に関しては弊社へお問い合わせください。

弊社プロセスフロー

ウエハプロセス → ウエハテスト → ダイシング → 個片化

ウエハ梱包	ウエハ梱包	チップ梱包	チップ梱包

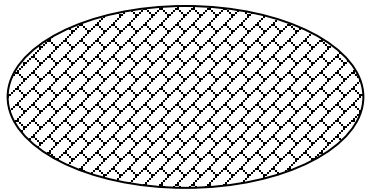
梱包形態

Unsawn wafer

ウエハ状態のまま専用のケースに収納し梱包・出荷します。

チップの使用期限はダイシング品に比べて長く、お客様の生産計画に合わせたウエハの使用が可能です。またお客様で最適なダイシング条件の設定が可能です。

保管期限：1年*

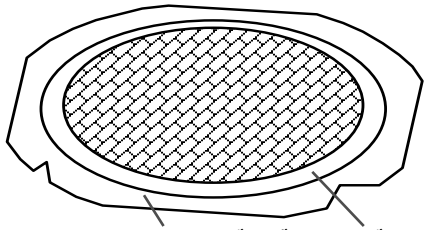


Sawn wafer

ダイシング後にウエハの状態で専用のケースに収納し梱包・出荷します。

お客様でのダイシング装置購入やメンテナンスコストが不要となります。またダイボンド時のウエハ搬送やチップ(マッピング)管理が容易となります。

保管期限：3か月(UV照射後から)*

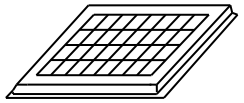


Chip tray

ダイシング後に弊社指定のトレイにチップを収納し梱包・出荷します。

Sawn waferに比べて保管エリアの省スペース化や使用期限の延長が見込めます。またチップ外観確認の容易さや接触や擦れを抑制することができます。

保管期限：1年*

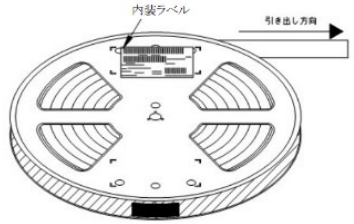


Tape reel ※量産対応は2027年4月以降

ダイシング後に弊社指定のリールにチップを収納し梱包・出荷します。

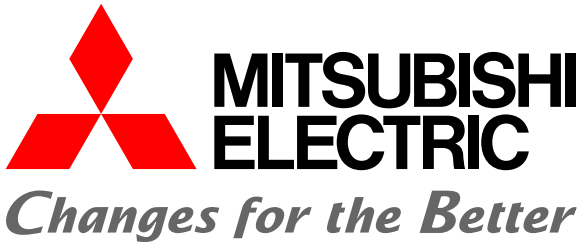
Chip trayに比べてダイボンド時の高速かつ連続的なチップ供給が可能となります。また供給方向(チップ向き)やピックアップ位置の管理が容易となります。

保管期限：1年*



*輸送期間は除く、未開封の状態で 5℃≦Ta≦30℃, 45%≦RH≦70% 環境で保管した場合の期限

© Mitsubishi Electric Corporation


MITSUBISHI
ELECTRIC
Changes for the Better